

# 第20回 半導体・センサ パッケージング技術展

通称 **ISP 2019**  
アイエスピー

## 奥野製薬工業(株) 展示会出展のご案内

記

会 期 : 2019年1月16日(水)～18日(金)  
10:00～18:00(最終日は17:00終了)  
開催場所 : 東京ビッグサイト 東3ホール  
小間番号 : E24-28  
招待券をお持ちの上、ご来場下さい。

### 出展品目

#### ◎半導体パッケージング技術用表面処理

- ・超微細回路形成
- ・接続信頼性に優れる無電解銅めっきプロセス
- ・レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤
- ・ファインパターン対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤
- ・超ファインパターン対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤
- ・半導体ウエハ用硫酸銅めっき添加剤
- ・スプレー装置対応樹脂上のパラジウム残渣除去液
- ・銅上の無電解金めっきプロセス/銅上の無電解パラジウム/金めっきプロセス

#### ◎パワーデバイス用表面処理

- ・耐クラック性・はんだ接合性に優れた無電解ニッケルめっき液
- ・無電解ニッケル/金、無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス
- ・銅素材上への無電解銀めっき液

#### ◎プリントドエレクトロニクス～IoT社会に向けて～

- ・環境配慮型プリント配線板製造プロセス
- ・無電解めっき向けシード層形成用ペースト

#### ◎電子材料用ガラス粉末

### 製品及び総合技術研究所紹介映像

「硫酸銅めっき添加剤～トップルチナシリーズ～」  
「総合技術研究所紹介」



東3ホール 出入口

◎半導体パッケージング技術用表面処理

- ・超微細回路形成
- ・接続信頼性に優れた無電解銅めっきプロセス「**OPC FLET**プロセス」
- ・レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤「**トップルチナLTF**」
- ・ファインパターン対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤「**トップルチナNSV**」
- ・超ファインパターン対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤「**トップルチナNPF**」
- ・半導体ウエハ用硫酸銅めっき添加剤「**トップルチナCP/SV/SD**」
- ・スプレー装置対応樹脂上のパラジウム残渣除去液「**OPCパラデリートIF**」
- ・銅上の無電解金めっきプロセス／銅上の無電解パラジウム/金めっきプロセス「**トップギルドプロセス／トップパラスプロセス**」

◎パワーデバイス用表面処理

- ・耐クラック性・はんだ接合性に優れた無電解ニッケルめっき液「**ICPニコロンLPW-LF**」
- ・無電解ニッケル/金、無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス「**トップUBPプロセス**」
- ・銅素材上への無電解銀めっき液「**トップシルベACC**」

◎プリントエレクトロニクス～IoT社会に向けて～

- ・環境配慮型プリント配線板製造プロセス「**EF-PWB PROCESS**」
- ・無電解めっき向けシード層形成用ペースト／ノーシアン高速無電解銅めっき液「**トップALP CP-1958／OPCカッパーNCA**」

◎電子材料用ガラス粉末